

วันที่รับงาน.....	หมายเลขรับงาน.....
नामผู้ขอใช้บริการ.....นามหัวหน้าโครงการ.....	
ห้องปฏิบัติการวิจัย.....ศูนย์วิจัย.....	
ที่อยู่.....	
เบอร์โทรศัพท์.....E-mail.....FAX.....	

ลักษณะโดยสังเขป เช่นขนาด, บริเวณที่ต้องการวิเคราะห์ (กรณีมีตัวอย่างจำนวนมาก กรุณาแนบเอกสารรายละเอียดแทน)
Sample ต้องมีขนาด < 1x1 เซนติเมตร, แห้งสนิท และไม่เป็นผง

เลือกลักษณะของการวิเคราะห์ (สามารถเลือกเป็นชุดหรือเลือกบางหัวข้อในแต่ละชุดได้)

- ☐ Surface Analysis*
- ☐ Survey Spectrum
 ☐ High Resolution
 ☐ Quantify Peak
 ☐ Component Analysis
 ☐ Export Raw Data
☐ Color Printing
- ☐ Etching (Damage surface)*
- ☐ Etch until reach substrate (Not recommend)
☐ Etch for time
☐ Etch for clean surface (Remove surface contamination)

สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

Ion Gun Energy..... Time per round.....

Etch area..... Etch Cycle.....

ลงชื่อ.....

หมายเหตุ

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่รับบริการหลังจากนั้นจะถูกลบออกจากกระบบฐานข้อมูล

กรณีต้องการทำ High Resolution กรุณาระบุธาตุที่ต้องการและ ช่วงของพลังงาน (Binding Energy)

1. ธาตุ.....	3.	5.
2.	4.	6.

กรณีตัวอย่างสกปรก หรือต้องการกำจัดผิวหน้าบางส่วนออก

- ☐ ใช้ Ion Gun ในการปรับผิว
 ☐ ไม่ใช้ Ion Gun ในการปรับผิว

กรณีเกิดปัญหา Auger Peak ทับซ้อนกับ Element Peak ในขณะที่ทำการวิเคราะห์

- ☐ ใช้ Mg Gun เพื่อแก้ปัญหา Auger Peak
 ☐ ไม่สนใจ Peak ที่มีปัญหาทับซ้อนกับ Auger Peak
☐ ติดต่อกลับก่อนเพื่อหาทางแก้ไข
 ☐ ยกเลิกการวิเคราะห์ Sample ที่มีปัญหา Auger Peak

สำหรับเจ้าหน้าที่

ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์โดยประมาณ.....บาท

กำหนดส่ง.....

วางเงินมัดจำ(50%).....บาท

รวมค่าบริการ..... บาท

วันส่งมอบ.....

ลงชื่อผู้ได้รับการบริการแล้ว

.....

(.....)

* หมายเหตุ

Survey Spectrum คือการวิเคราะห์ผิวโดยรวมซึ่งจะแสดงธาตุที่มีออกมาทั้งหมดในกราฟเดียว

High Resolution คือการเลือกวิเคราะห์ธาตุใดธาตุหนึ่งเช่น C, N, O เป็นต้น

Quantify Peak คือการทำรายงานเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าตัวอย่างประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างและมีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์

Component Analysis คือการระบุว่าในธาตุนั้นๆ มีการรวมตัวกันอย่างไรบ้างทางเคมี (Chemical Bonding)และมีอยู่ที่เปอร์เซ็นต์และมีพลังงานเท่าไร

Etching คือกระบวนการในการใช้ Ion Gun ในการถากผิวของตัวอย่างออกเพื่อจัดความสกปรกของผิว หรือต้องการดูผิวของSubstrate หลังจากที่ถูกถากออกไปแล้ว ทั้งนี้เมื่อใช้ Etching จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นบนผิวของตัวอย่าง